

チップレット設計基盤構築に向けた技術開発事業

商務情報政策局情報産業課

令和5年度予算額 **5.0 億円** (**新規**)

事業の内容

事業目的

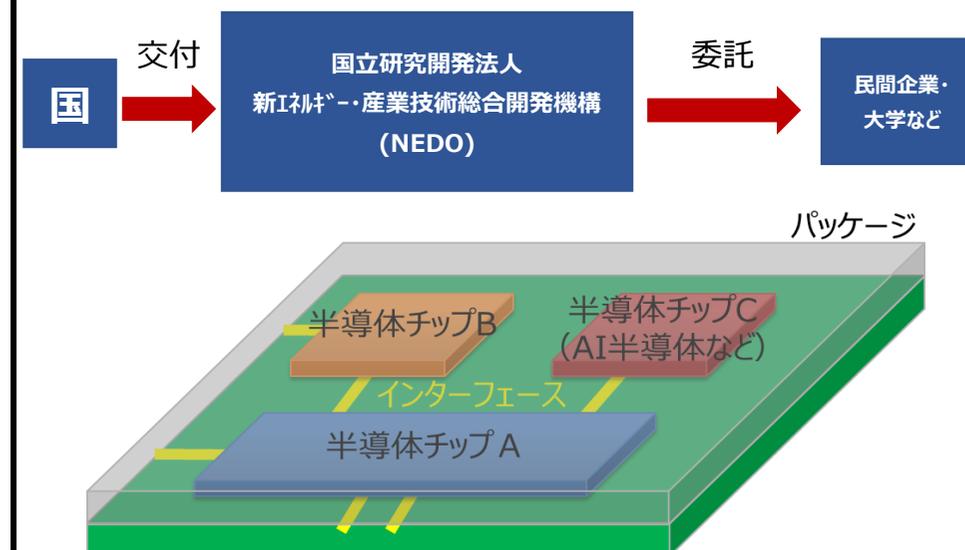
デジタル化の進展に伴う情報量の急増により効率的な情報処理が求められており、クラウドデータセンターに加え、端末側でも分散して情報処理を行うエッジコンピューティングの開発が進んでいます。高度なエッジコンピューティングには、AIも含めた半導体の高性能化に加え、多数の端末で用いられるため低コスト化も必要です。性能とコストの両立には、集積回路を構成するCPUやGPU等の要素をパーツ毎に最適な微細度で設計し、高性能動作が可能な配置で3次元実装するチップレット技術が重要です。本事業では、チップレット技術の実用化に向けた設計基盤技術とエッジコンピューティングで用いるAI半導体を開発します。

事業概要

本事業では、チップレット型カスタムSoC(※)基盤設計技術開発に取り組みます。具体的には、エッジコンピューティング向けチップレット型カスタムSoCの共通課題となる高効率アーキテクチャ、回路の設計及び実装基盤技術を開発します。

※System on a Chip : 1つのチップ上に、CPUやGPU等の要素を集積して特定の機能を実現する半導体チップ。

事業スキーム (対象者、対象行為、補助率等)



成果目標

令和5年度から令和9年度までの5年間の事業であり、AI半導体設計における設計期間の短縮、低コスト化などを目指します。これにより、中小・ベンチャー企業などが持つユニークなアイデアのPoCの加速を目指します。